

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制的 2023 年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]195 号文《关于同意上海新阳半导体材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，本公司于 2021 年 4 月向特定对象发行普通股（A 股）股票 22,732,486 股，募集资金总额 79,199.98 万元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为 78,753.97 万元。本次募集项目资金于 2021 年 4 月存入公司募集资金专用账户中，并已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字（2021）第 03522 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

公司于 2021 年 4 月向特定对象发行普通股（A 股）股票 22,732,486 股，募集资金总额 79,199.98 万元，根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字（2021）第 03522 号《验资报告》，本次向特定对象发行股票扣除不含税发行费用后的募集资金净额为 78,753.97 万元。天风证券股份有限公司从募集资金总额中提取的承销保荐费用（含税）为 396 万元。天风证券股份有限公司将扣除承销保荐费用（含税）后的资金打款到本次募集资金专户中，金额为 78,803.98 万元，其中含未能及时置换发行费用 50.01 万元，扣除后实际募集资金净额为 78,753.97 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金使用及余额情况具体如下：

单位：人民币万元

项目名称	本次募集资金金额	期初募集资金余额	本期实际使用金额	募集资金期末余额
集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目	42,553.97	37,341.16	2,936.21	34,404.95
集成电路关键工艺材料项目	21,200.00	9,099.85	9,099.85	-
补充流动资金	15,000.00	-	-	-
合计	78,753.97	46,441.01	12,036.06	34,404.95

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。本公司对募集资金实行专户存储，并分别与保荐机构和开户银行签订了《募集资金三方监管协议》及其补充协议。

（二）募集资金在各银行账户的存储及变更情况

本公司为本次向特定对象发行股票募集资金开设了四个专项账户，分别为开户行：上海银行股份有限公司松江支行（以下简称“上海银行松江支行”）账号为 03004477827；开户行：中国建设银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“建行松江支行”）账号为：31050180360000003196；开户行：宁波银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“宁波银行松江支行”）账号为：70040122000491141；开户行：浙商银行股份有限公司上海分行（以下简称“浙商银行上海分行”）账号为：2900000010120100728563。本公司已连同保荐机构天风证券股份有限公司分别与上海银行松江支行、建行松江支行、宁波银行松江支行和浙商银行上海分行签订了《募集资金三方监管协议》并发表：2021-024 公告。

截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金专项账户的余额如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	开户银行	账号	期末余额
1	集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目	浙商银行上海分行	2900000010120100728563	160,270,405.90
2	集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目	宁波银行松江支行	70040122000491141	54,895,504.78
3	集成电路关键工艺材料项目	上海银行松江支行	03004477827	3,230,657.29
4	补充流动资金	建行松江支行	31050180360000003196	12,583.95
	合计			218,409,151.92

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的本次募集资金合计 344,049,457.06 元，未能及时置换发行费用合计 500,125.04 元，累计产生利息收入 36,861,822.62 元，其中 3,002,252.80 元利息收入已使用于募投项目；进行结构性存款的闲置募集资金 160,000,000.00 元（相关公告编号：2023-068），募集资金账户余额合计 218,409,151.92 元。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，本公司募集资金的使用情况详见附表-1“2023 年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期，本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点或实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司本次向特定对象发行股票无以募集资金置换自有资金的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

本报告期，本公司不存在节余募集资金。

（六）超募资金使用情况

本公司向特定对象发行股票无超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的本次募集资金合计 344,049,457.06 元，未能及时置换发行费用合计 500,125.04 元，累计产生利息收入 36,861,822.62 元，其中 3,002,252.80 元利息收入已使用于募投项目；进行结构性存款的闲置募集资金 160,000,000.00 元（相关公告编号：2023-068），剩余募集资金余额合计 218,409,151.92 元均存放在募集资金专项账户中。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期，募集资金使用无其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格遵守深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定，规范管理和使用募集资金，并及时对外披露，不存在管理和使用违规情况。

附表 1：2023 年度募集资金使用情况对照表

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2024 年 2 月 28 日

附表 1：2023 年度募集资金使用情况对照表（单位：万元）

募集资金总额		78,753.97					本报告期投入募集资金总额		12,036.06		
报告期内变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		44,349.02		
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截至报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目	否	42,553.97	42,553.97	2,936.21	8,149.02	19.15%		-3,681.28	-15,183.99	否	否
集成电路关键工艺材料项目	否	21,200.00	21,200.00	9,099.85	21,200.00	100.00%	2024 年一季度	-43.14	-126.41	否	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	100.00%		-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	否	78,753.97	78,753.97	12,036.06	44,349.02			-3,724.42	-15,310.40		
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计											
合计		78,753.97	78,753.97	12,036.06	44,349.02			-3,724.42	-15,310.40		

附表 1：2023 年度募集资金使用情况对照表（单位：万元）（续）

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	未达到项目计划进度的情况和原因详见同日发布的公告 2024-010。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的本次募集资金合计 344,049,457.06 元，未能及时置换发行费用合计 500,125.04 元，累计产生利息收入 36,861,822.62 元，其中利息收入中已用于募投项目的金额为 3,002,252.80 元；进行结构性存款的闲置募集资金 160,000,000.00 元（相关公告编号：2023-068），募集资金账户余额合计 218,409,151.92 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期内披露的关于集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目相关效益计算包含自有资金投入。本报告中披露的关于集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目与前次募集资金中 193nm（ArF）干法光刻胶研发及产业化项目系同系列最终产品，所以该项目的收益指标与 193nm（ArF）干法光刻胶研发及产业化项目统一计算。